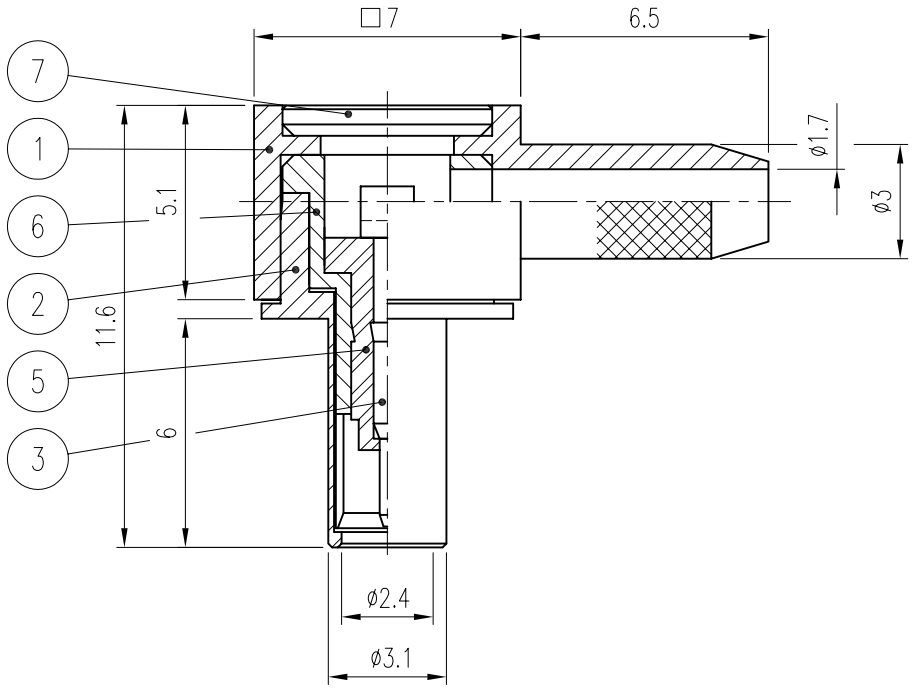
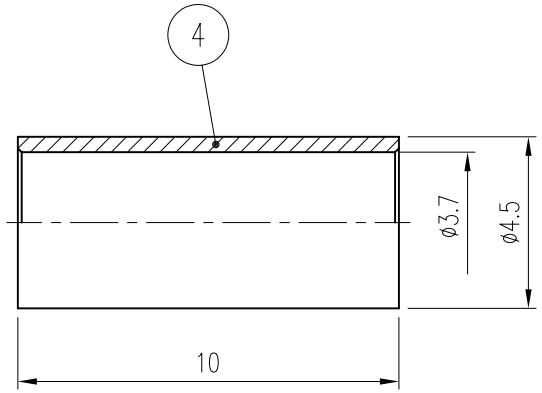
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	공정개선[설변처리No.연구200809-007] CABLE심선 납땜시 냉땜 발생 방지	윤상진	윤상진	2008. 09. 19.
2	공정개선[설변처리No.연구200810-0007] COVER 빠짐 방지 공차 변경	윤상진	윤상진	2008. 10. 07.

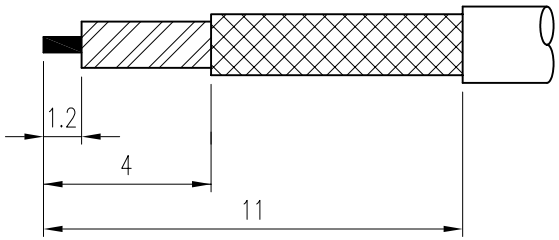




주 기

1. 이탈력 Spec. : 0.3(+0.2) kgf

	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
2	7	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00076-5/1 ~~DCO00040-5/1 (L3018)~~
	6	JACK	1	BeCu	Nickel Plate	DJA00109-5/1
	5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01288-N/1
	4	FEERULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00043-5/1 (F6007)
1	3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01679-5/1 ~~DCT01519-5/1~~
	2	BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01991-5/1
	1	BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01990-5/1



CABLE 탈피도

대체가능재질	년월일	2008. 4. 19.	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인		KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
재질	검도		도명 KMS-LP FUJIKURA VER.2
열처리	제도		
보호피막처리	작성부서	연 구 소	A4 도번 CN01989-7/3
	척도 5/1	단위 mm	중량 —